

研削・研磨の流れ

			片面研削・研磨	片面研削・研磨	片面研削・研磨	片面研削・研磨	両面研削・研磨
対応装置		手磨き	NVG200A 薄片で反りが生じる	FACT200 薄片で反りが生じる	NF300 薄片で反りが生じる	NF300HP 薄片で反りが生じる 高負荷作業用	NDF-4BL 薄片でも反りなし 平行平面出し
試料調整	表面粗さ	薄片、ウエファー（貼付け盤に貼付け） ブロック 埋込み成形（3個、6個掛けホルダー）	AC100V 真空チャック 最小径：φ80mm またはネジ固定 中央部φ10mm穴 水冷：循環または垂れ流し	AC100V 試料支持ユニット ・強制駆動エアブレスユニット 1または2組 ・強制駆動ローラーガイドリングユニット 1または2組 ・ボールポイントユニット 1または2組 (スリラー供給) 自動噴霧装置ナノデイスパンサー 自動滴下装置ナノドリッポンプ	AC100V 2組または4組 2組または4組 2組または4組	AC200V3相 2組または4組 2組または4組 2組または4組	AC100V 片面 1組 片面 1組 片面 1組
研削	>100μ	耐水研磨紙 #80～200 レジン、電着ダイヤモンド盤	研削砥石 砥石 #100～400	底盤、砥粒 ナノディスク鉄定盤 6～45μダイヤスラリー	底盤、砥粒 ナノディスク鉄定盤 6～45μダイヤスラリー	底盤、砥粒 ナノディスク鉄定盤 6～45μダイヤスラリー	底盤、砥粒 鉄定盤 砥粒 GC キャリアー 4組 循環または 垂れ流し
研磨	10～100	#300～800	#300～600 仕上り：裂地	ナノディスク銅定盤 3～15μダイヤ	ナノディスク銅定盤 3～15μダイヤ	ナノディスク銅定盤 3～15μダイヤ	試料最大φ90 サイズにより多数個同時研磨可能 修正法：修正キャリアー ナノディスク銅定盤 ダイヤスラリー 6μ
研磨	1～10	#1000～	#1000～#6000 仕上り：鏡面 Ra:1μ	ナノディスク錫硬定盤 ナノディスク錫定盤 1～1/4μダイヤ	ナノディスク錫硬定盤 ナノディスク錫定盤 1～1/4μダイヤ	ナノディスク錫硬定盤 ナノディスク錫定盤 1～1/4μダイヤ	ナノディスク錫硬定盤 ナノディスク錫定盤 1～1/4μダイヤ
ポリッシング	1μ<	研磨パッド ダイヤモンドペースト アルミナスラリー 酸化セリウム コロイダルシリカ	#8000～#20000 仕上り：鏡面 Ra:2nm	ポリッシング アルミ (SUS) 定盤 各種パッド スラリー 1/4～1μダイヤ アルミナ、酸化セリウム	ポリッシング アルミ (SUS) 定盤 各種パッド スラリー 1/4～1μダイヤ アルミナ、酸化セリウム	ポリッシング アルミ (SUS) 定盤 各種パッド スラリー 1/4～1μダイヤ アルミナ、酸化セリウム	ポリッシング アルミ (SUS) 定盤 各種パッド スラリー：コロイダルシリカ
CMP	nm		随時ドレッシング砥石 仕上げ：ポリッシング装置	CMP加工 特殊パッド ダイヤモンドドレッサー ウエファー用テンプレート スラリー：コロイダルシリカ	CMP加工 特殊パッド ダイヤモンドドレッサー ウエファー用テンプレート スラリー：コロイダルシリカ	CMP加工 特殊パッド ダイヤモンドドレッサー ウエファー用テンプレート スラリー：コロイダルシリカ	
			(ナノディスク盤修正) 自動定盤修正機構 または電着リング	(ナノディスク盤修正) 自動定盤修正機構 または電着リング	(ナノディスク盤修正) 自動定盤修正機構 または電着リング	(ナノディスク盤修正) 自動定盤修正機構 または電着リング	(ナノディスク盤修正) 自動定盤修正機構 または電着リング